

Ansys Simulation World 2026 Japan Agenda



part of

Synopsys



10:00-11:50					
K-1 ご挨拶 アンシス・ジャパン株式会社 エリアバイスプレジデント 日本カンントリーマネージャー 浅井 一輝  Keynote The Next Frontier of Innovation: Engineering Faster with Confidence SVP, S&A Customer Excellence Synopsys, Inc. Anthony Dawson		Keynote Defining the Next Era of Engineering Senior Vice President of Product Management Synopsys, Inc. Steve Pytel 	Special Session 全固体電池開発における、 デジタルツインの可能性 株式会社本田技術研究所 統合研究センター エネルギーユニット生技研究開発室 第2ブロック チーフエンジニア 赤堀 重人 氏 	Special Session Synopsys と NVIDIA が切り拓く エンジニアリングの未来 エヌビディア合同会社 ソリューションアーキテクト HPCソリューションアーキテクト 丹 愛彦 氏 	Special Session 勝利を支えたシミュレーション活用 名古屋大学フォーミュラチームFEM 名古屋大学 フォーミュラチームFEM 赤松 駿 氏 藤井 一弥 氏 
Room A	Room B	Room C	Room D	Room E	Room F
12:10-12:50					
1-3 解析はAIエージェントに自然言語で依頼する時代へ ～Ansys part of Synopsys × NVIDIA × HPが描くAI Agent時代のCAE～ 株式会社 日本HP 勝谷 裕史 氏 エヌビディア合同会社 田中 秀明 氏 アンシス・ジャパン株式会社 宣場 慎二	1-6 ハードウェアの制約を解消し、研究開発サイクルを加速 ～ Ansys×Rescaleで実現する クラウドHPCと解析データ活用 ～ Rescale Japan株式会社 佐藤 仁 氏	1-1 ノイズの仮説構築から対策検証まで、 設計段階で進めるEMCフロントローディング サイバネットシステム株式会社 山本 悦史 氏 久禮 寛大 氏	1-4 Ansys Maxwell/Ansys Motor-CADと AIエージェントを連携した自律型モータ設計システム 株式会社MotorAI 清水 悠生 氏	1-5 多様化する半導体パッケージ実装設計を支援する CR-8000 Design Forceのご紹介 株式会社図研 松澤 浩彦 氏	1-2 設計・開発を変革するクラウドCAE ～Ansys part of Synopsys × AWSによる スケーラブルシミュレーション～ アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 舩重 国規 氏
13:05-13:45					
2-1 Ansys DiscoveryとAnsys GeomAIを用いた、 外装性能開発におけるテスト置換に向けた取り組み 株式会社本田技術研究所 樋渡 一晃 氏 菅原 昂也 氏	2-6 ものづくりの未来を創る理工系人材の発掘と育成 東京科学大学 荒木 稚子 氏	2-2 中国現地ニーズに対応した シミュレーション活用拡大の取り組み パナソニック株式会社 堀端 裕司 氏 郭 歆歆 氏	2-4 原子スケールシミュレーションが拓く新たな R&D インサイト ― スケールを超えて実験・シミュレーション・ 理論をマテリアルズインフォマティクスを軸に 結ぶ R&D エコシステムへの展望 ― アンシス・ジャパン株式会社 植田 正輝	2-5 光学レンズのズレ推定に向けた機械学習の新手法 - Ansys Zemax OpticStudio × Ansys optiSLang × PyTorchを 活用したアプローチ - アンシス・ジャパン株式会社 Hsiao Yihua	2-3 パワー-MOSFETの低ゲート電圧動作時における ホットスポット発生メカニズム解析 東芝デバイス&ストレージ株式会社 荻谷 平 氏
14:00-14:40					
3-4 AI時代の脱炭素化を支えるCFDの活用 アンシス・ジャパン株式会社 弥永 鴻志		3-1 次世代デバイスの価値を最大化する ロームのソリューション - Ansys AEDTを活用した ソリューション開発 - ローム株式会社 安武 一平 氏	3-2 ソフトウェア定義型製品を支える エレクトロニクス・デジタルツイン 日本シノプシス合同会社 Sylvain Bayon de Noyer	3-3 CPO設計を加速するマルチフィジックス連成解析手法 - Ansys Lumericalと Synopsys OptoCompilerと TCADによる連成- アンシス・ジャパン株式会社 メンデス マヌエル	3-5 Ansysツールを活用したヘテロジニアス インテグレーションの実現可能性評価 アルティメイトテクノロジズ株式会社 松倉 涼太 氏
15:00-15:40					
4-3 Ansys LS-Dynaの進化 ～衝突からエレクトロニクス・半導体への適用領域の 拡大と解析の民主化～ アンシス・ジャパン株式会社 松田 和弘		4-2 パワーエレクトロニクスシステムの熱設計から 運用までをつなぐデジタルツイン活用事例 アンシス・ジャパン株式会社 橋口 直矢	4-1 走行中無線給電における 鉄筋コンクリートの影響低減技術検討 株式会社豊田中央研究所 高橋 篤弘 氏	4-5 画像データから3Dモデルを作成 ― Ansys Simplewareの機能と活用事例 株式会社JSOL 長谷川 航 氏	4-4 Ansysの最新GPUテクノロジーが実現する、 大規模かつ複雑なシナリオの フルフィジックス電磁界シミュレーション アンシス・ジャパン株式会社 グェン スアン トゥン
16:00-16:40					
5-2 Agentic AIで実現する解析自動化 ―Synopsys.ai Autopilotと PyAnsys™/MCP連携― アンシス・ジャパン株式会社 岡本 竜馬 長坂 和佳		5-1 AIによる電子機器設計の革新 ～Ansys SimAIによる新たな設計アプローチ～ アンシス・ジャパン株式会社 萩原 直樹	5-5 ミッション設計から飛行評価までを支える Ansys STK活用事例 宇宙航空研究開発機構 高橋 俊 氏	5-4 ソフトウェアにより進化する車両システムの 一気通貫開発と早期検証の実現 アンシス・ジャパン株式会社 児玉 亮	5-3 基板の設計フェーズに応じたはんだの 熱疲労解析手法の紹介 -Ansys Sherlockと Ansys Mechanical- アンシス・ジャパン株式会社 末藤 啓
17:00-17:40					
6-4 GPUで実現する次世代シミュレーション ― 構造・流体・電磁界・光学解析の 最新ソルバーと高速解析事例 ― アンシス・ジャパン株式会社 土屋 幸治 琴浦 彰彦 森山 貴裕		6-3 はんだ形状予測を用いた応力シミュレーションによる 信頼性向上への取り組み ～Ansys LS-DYNAによるアプローチ～ 東芝デバイス&ストレージ株式会社 阿部 慶樹 氏	6-5 車両システムから半導体まで ―サプライチェーン・部門間を横断する 機能安全ソリューション アンシス・ジャパン株式会社 朱 家立	6-1 3次元実装半導体デバイスにおける Simulationの活用事例 東京科学大学 良尊 弘幸 氏 中條 徳男 氏	6-2 MBSE/MBDを活用した設計開発の在り様 アンシス・ジャパン株式会社 大西 雄介
18:00-19:30					
ネットワーキング					